

全自动晶圆打码机

AUTOMATIC WAFER CODING MACHINE

晶圆打码机是专业化的全自动晶圆激光打标专用设备,分别适用于8"-12"晶元的Wafer Marking作业; 适用于Si、Ge、SiC、GaN、InP、Sapphire、Quartz等; 适用于waferID打码及晶圆级封装打码。

It is a professional automatic wafer laser marking machine , respectively Suitable for 8 "-12 " Wafer Marking; Suitable for Si、 Ge、 SiC、 GaN、 InP、 Sapphire; Suitable for wafer ID coding and wafer-level package coding.



VLS-AUTO-WLM-532-Power (5W)

产品参数

Product parameters

项目 Parameter	规格 Value
适用晶圆尺寸类型 Wafer Size Type	2~8 inch
适用晶圆厚度 Wafer Thickness	200~2000 μm
料位 Material Level	总计3个料位，兼容2-8英寸夹具 Total 3 material levels, compatible with 2-8 inch fixtures
芯片传送及抓持方式 Transport Mode	机械手臂搬运，真空吸盘负压吸附抓持 Mechanical arm handling, vacuum suction cup negative pressure adsorption grasp
正片方式 Positive Film Mode	智能视觉图像识别定位边，无需机械正片 Image recognition
“正片”识别定位精度 Positioning Accuracy	≤0.1°、ΔX = ±0.05mm、ΔY = ±0.05mm
字体 Typeface	常规字体及SEMI字体，支持客户自设计字体 Regular fonts and SEMI fonts, support customer designed fonts
字型 Font	点阵字体或细线体 Dot font or thin line
温湿度 Temperature & Humidity	Temperature 10°C~40°C、Humidity 5%~95%
字符大小 Character Size	用户可选 User optional
字体可调节内容 Font Adjustable Content	字体高、宽、深度、字数、字体清晰度 Font height, width, depth, word count, font clarity
破片率 Fragment Rate	≤0.001%
打标位置重复性 Repeatability	< ±0.05mm
粉尘控制 Dust Control	配备FFU及HEEAP系统 FFU and HEEAP system
激光器类型 Laser Type	绿光纳秒激光器 Green nano-second lase
外形尺寸 Size	1300x1000x1600mm

切割成品展示

Finished product show

